

附件1:

国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2013年调整)

编号	名称	技术规格要求	销售业绩要求	修订说明
二、超、特高压输变电设备				
(一)直流输变电设备				
1	直流换流变压器	±600kV及以上	持有合同订单	调整技术规格
2	换流阀	±800kV及以上	持有合同订单	调整技术规格
3	直流输电用晶闸管	±800kV及以上	持有合同订单	调整技术规格
4	控制保护设备	±800kV及以上	持有合同订单	调整技术规格
5	直流场设备	±800kV及以上	持有合同订单	新增
(二)交流输变电设备				
1	电力变压器、六氟化硫断路器、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、串联补偿装置	750kV及以上	持有合同订单	调整技术规格及零部件
三、大型石化设备和石油钻采装备				
(四)对苯二甲酸(PTA)成套设备				
4	PTA工艺空气压缩机组	年产量≥80万吨	持有合同订单	调整零部件清单
四、大型煤化工设备				
(三)大型空分设备及其压缩机、空压机、增压机				
1	大型空分设备	氧产量≥40000Nm ³ /h	持有合同订单	调整零部件清单
六、大型煤炭设备				
(三)大型煤炭采掘设备				
2	刮板输送机和刮板转载机	刮板输送机装机功率≥800千瓦,刮板转载机装机功率≥400千瓦	年销售量≥10台(套)	调整零部件清单
3	液压支架	工作阻力4600千牛顿以上支撑掩护式支架、5000千牛顿以上薄煤层双柱式掩护支架、6400千牛顿以上大采高支架和放顶煤支架	年销售量≥50台	删除
八、高速铁路、城市轨道交通设备				
(六)高速铁路信号系统				
1	车载设备	适用于200Km及以上动车组	持有合同订单	新增
2	列控地面安全数据网系统	整机交换容量≥5.6Gbps,整机转发性能≥1Mpps	持有合同订单	新增
3	地面应答器系统	单机有效数据容量831bit以上	持有合同订单	新增
九、大型环保及资源综合利用设备				
(四)资源综合利用设备				
8	生活垃圾精分选成套系统装备	分选精度≥98%,分选率≥90%	持有合同订单	新增
十、大型施工机械和基础设施专用设备				
(一)大型、新型施工机械				
4	混凝土泵车	臂架长度≥40米	年销售量≥100台	调整零部件清单
14	举高消防车	工作高度≥40米	持有合同订单	新增
十三、新型纺织机械				
(七)染色机				

附件1:

国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2013年调整)

编号	名称	技术规格要求	销售业绩要求	修订说明
1	高温高压溢流染色机	浴比≤1:4.5, 设计温度≥140℃, 设计压力≥3.0 bar	持有合同订单	新增
2	气流染色机	浴比≤1:2.5, 设计温度≥140℃, 设计压力≥3.0 bar	持有合同订单	新增
3	纱线染色机	浴比≤1:4, 设计温度≥140℃, 设计压力≥5.2 bar	持有合同订单	新增
十四、新型、大马力农业装备				
(二)	水稻联合收割机	配用动力≥29千瓦, 行数≥4行, 立式割台, 履带式	年销售量≥80台	修改名称
(十)	自走轮式谷物联合收割	功率≥88千瓦	年销售量≥50	新增
(十一)	大马力拖拉机配套耕整地机械	配套动力≥88千瓦	年销售量≥50台	新增
(十二)	甘蔗收获机	自走式, 发动机额定功率≥68千瓦	持有合同订单	新增
(十三)	自走式喷杆喷雾机	药箱容积≥1000升	持有合同订单	新增
十五、电子信息及生物医疗装备				
(一) 集成电路关键设备、新型平板显示器件生产设备、电子元器件生产设备、表面贴装及无铅工艺的整机联装设备				
1、太阳能电池设备				
(5)	晶硅太阳能电池生产用全自动印刷、烘干、烧结、测试分选系统	硅片(多晶、单晶)尺寸: 156mm×156mm	持有合同订单	调整名称及零部件清单
(6)	太阳能级单晶炉、多晶铸锭炉	单晶炉投料量≥150KG; 多晶铸锭炉一次投料量≥800KG	持有合同订单	新增
(7)	扩散炉	硅片(多晶、单晶)尺寸: 156mm×156mm	持有合同订单	新增
(8)	铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池硒化、热处理	基板尺寸0.6×1.2m; 最高温度≥500度	持有合同订单	新增
2、半导体发光二极管(LED)生产设备				
(2)	等离子刻蚀机	托盘尺寸: 330mm及以上; 产能: 氮化钾27片及以上, 蓝宝石22片及以上; 刻蚀速率: 氮化钾≥120nm/min, 蓝宝石≥70nm/min	持有合同订单 年产10台以上	调整零部件清单
(3)	氧化铟锡(ITO)溅射台	沉积速率>10Å/s、沉积均匀性<±3%	持有合同订单	调整销售业绩要求
3、集成电路关键设备				
(1)	氧化炉	硅片直径300mm, 线宽65-90nm	持有合同订单	新增
(2)	单晶硅棒多线切割机	硅片直径200-300mm	持有合同订单	新增
(3)	高密度等离子刻蚀机	(1) 硅片直径200mm, 线宽0.18-0.10μm; (2) 硅片直径300mm, 线宽45-90nm	持有合同订单	新增

附件1:

国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2013年调整)

编号	名称	技术规格要求	销售业绩要求	修订说明
(3)	高密度等离子刻蚀机	(1) 硅片直径200mm, 线宽0.18-0.10 μ m; (2) 硅片直径300mm, 线宽45-90nm	持有合同订单	新增
(4)	薄膜沉积设备	线宽 \leq 0.13 μ m工艺的 化学气相沉积设备 (CVD); 线宽 \leq 65nm 物理沉积设备(PVD)	持有合同订单	新增
(5)	芯片加工前道清洗设备	硅片直径300mm, 线宽 65-90nm	持有合同订单	新增
4、新型平板显示器件生产设备				
(1)	TFT-LCD偏光片贴附机	用于4.5代及以上工艺	持有合同订单	新增
(2)	TFT-LCD用划线机	用于4.5代及以上工艺	持有合同订单	新增
5、锂离子动力电池设备				
(1)	锂离子电池生产用涂覆设备	涂布速度: 20~ 70m/min; 单面涂布厚 度 \leq 300 μ m; 最大涂布 宽度 \geq 700mm	持有合同订单	新增
(2)	锂离子电池极片分切设备	最大放卷幅宽 \geq 670mm; 可分切极片厚 度50~300 μ m; 分切精 度 \leq \pm 0.05mm	持有合同订单	新增
6、其他电子元器件生产设备				
(1)	低温共烧陶瓷(LTCC)基板制造设备	基板尺寸200mm \times 200mm 或直径200mm; 层数 \geq 30层	持有合同订单	新增

备注: 本目录的编号在财关税[2012]14号文件附件2已有编号的基础上编制。